



ICAC
2025



第七届华人芯片设计技术研讨会

主办单位



支持单位

河套深港科技创新合作区深圳园区发展署

承办单位

华芯设集成电路技术中心



第七届华人芯片设计技术研讨会（ICAC 2025）于2025年3月25日至28日于深圳福田香格里拉酒店召开，会议为期4天，汇聚国内IC芯片设计领域的顶尖力量。华人芯片设计技术研讨会（ICAC）长期致力于为中国集成电路设计的学术界和产业界同仁建立一个顶尖的技术交流平台，会议只邀请过去两年中在集成电路设计领域顶级期刊（ISSCC 或JSSC）发表过优秀论文的中国顶尖IC设计学者和工程师做学术报告，旨在营造开放的技术讨论氛围，集思广益，共同提高，攻克“卡脖子”难题。

102 特邀报告人

93 学生海报

15 赞助企业

800 参会者

会议现场



开幕式 & 大会报告



大会主持人
陈迟晓 复旦大学



大会主席致辞
路延 清华大学



大会报告嘉宾
张波 电子科技大学



大会报告嘉宾
马凯学 天津大学



大会报告嘉宾
尹首一 清华大学

本次大会邀请了电子科技大学张波教授、天津大学马凯学教授、清华大学尹首一教授作重磅大会报告，同时还邀请了来自清华大学、北京大学、复旦大学、澳门大学、香港科技大学等国内知名高校及企事业单位的90余位专家作邀请报告。这也是ICAC自2018年创办以来报告专家数量首次突破百位大关，彰显了近年来中国IC设计在国际上的蓬勃生机。

同时，会议积极组织了芯片设计培训班、学生海报展示、企业宣讲会等环节。这些活动旨在激发更多人对芯片设计领域的研究兴趣，并为大家提供一个交流与学习的平台，希望参与者能够从中获得启发，将所学知识应用到实际工作中，共同推动中国IC设计在国际上的蓬勃发展。

分论坛&学生海报



自首届会议以来，亚昂全程深度参与会议的各个方面，包括学术内容的策划、参会嘉宾的邀请、现场服务和宣传管理等。在IC设计领域迅速变化的全球背景下，为每一届会议提供新的前沿解决方案，确保会议顺利举行，不断扩大会议的影响力及品牌效应。

